

AI智慧電路板學程 說明會

人力資源處 李筱萍經理
2025.11.19



一分鐘認識臻鼎



全球第1大

印刷電路板製造公司

2006年 成立
(前身華虹電子 1978)

台灣桃園 總部

48,141
2024年底員工數



32 座工廠

位於大陸、台灣、泰國、
印度

NT\$1,716.6億

2024年營收(13.4% YoY)

NT\$1,577億

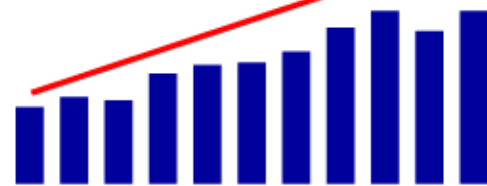
2025年10月16日市值

13.3%

10年平均股東權益報酬率
(2015-2024)

+9%

2014-2024年
營收年複合成長率



未來關鍵成長動能

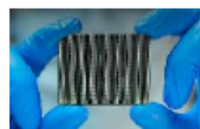
AI伺服器/光通訊



AI眼鏡



IC載板

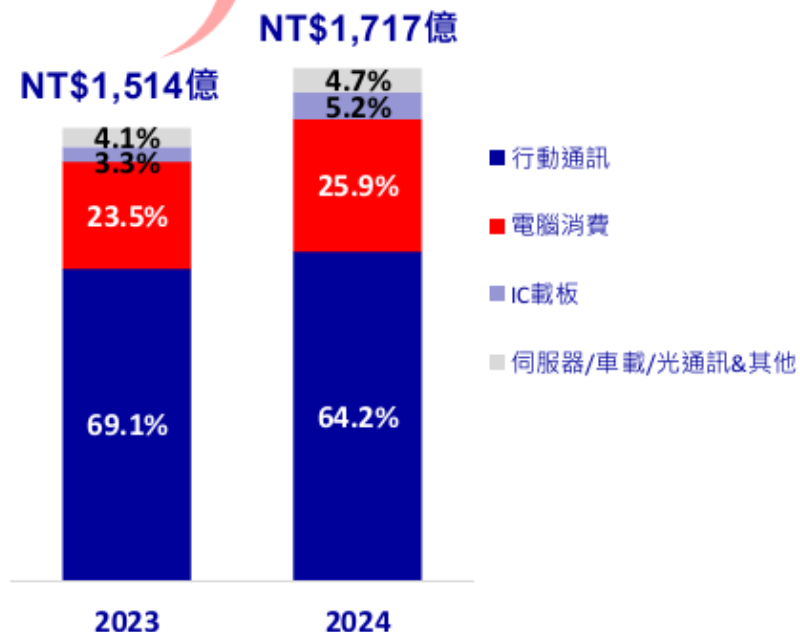


折疊手機



銷售分析 – 產品應用別

+13.4% YoY

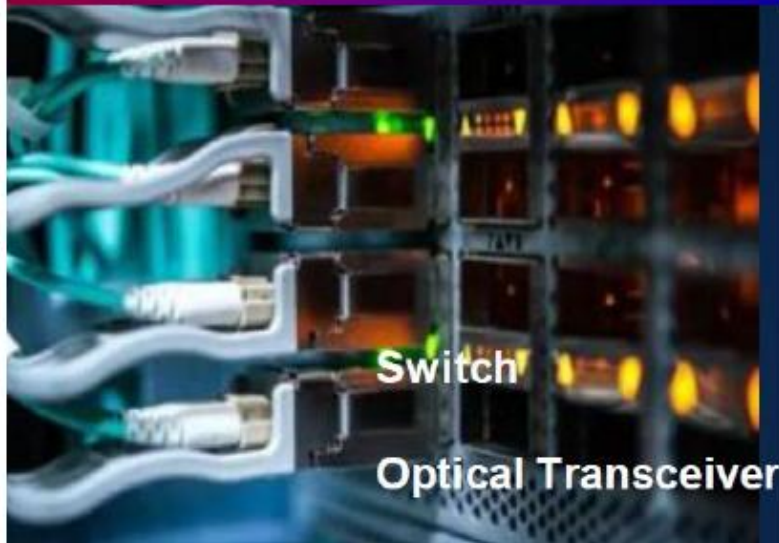


高階PCB到載板 ZDT提供完整的異質整合解決方案

雲



管



端



HLC

Intelligent HDI

ICS

High Accuracy
HDI

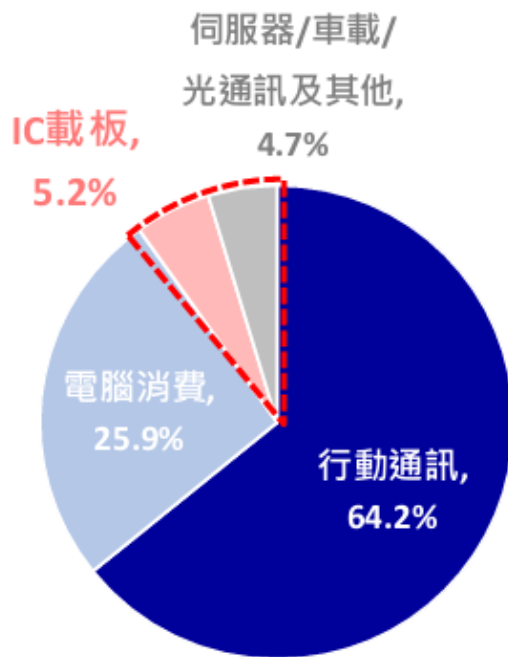
High Density

Big Size & High
Stacked Layers

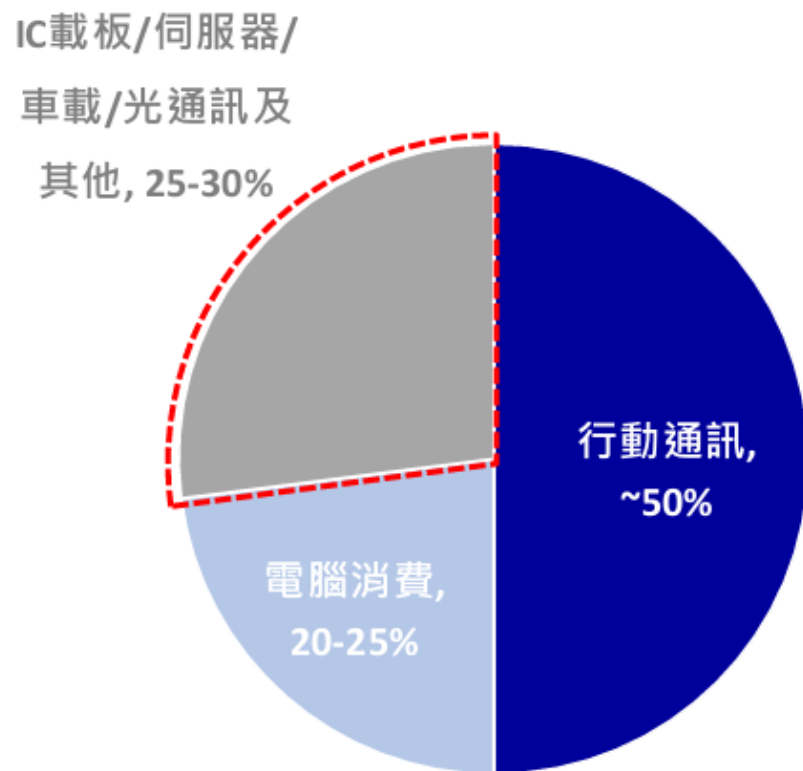
High Speed
Material

穩步推進伺服器與IC載板佈局，持續擴大營收貢獻

臻鼎：2024年產品應用營收佔比



臻鼎：2030年目標產品應用營收佔比

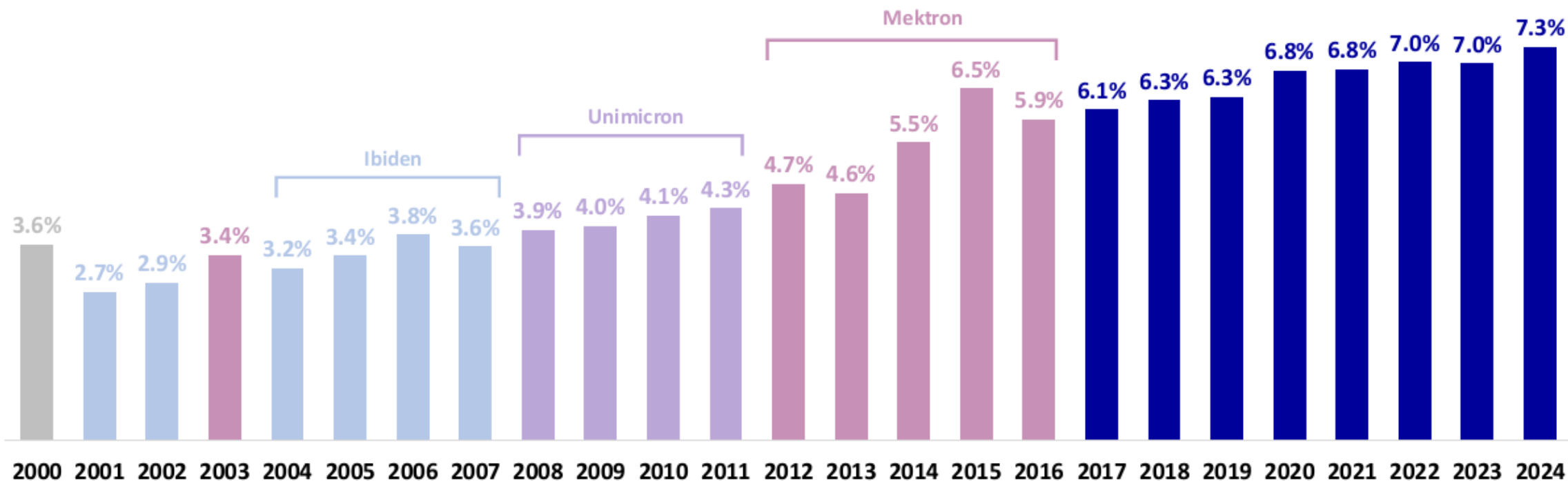


臻鼎持續居於產業領先地位

歷年全球最大PCB廠商市佔率

■ Sanmina ■ Ibiden ■ Mektron ■ UMTC ■ ZDT

臻鼎連續 8 年市佔率全球第一
(且為PCB產業歷年來首家突破7%市佔率的公司)

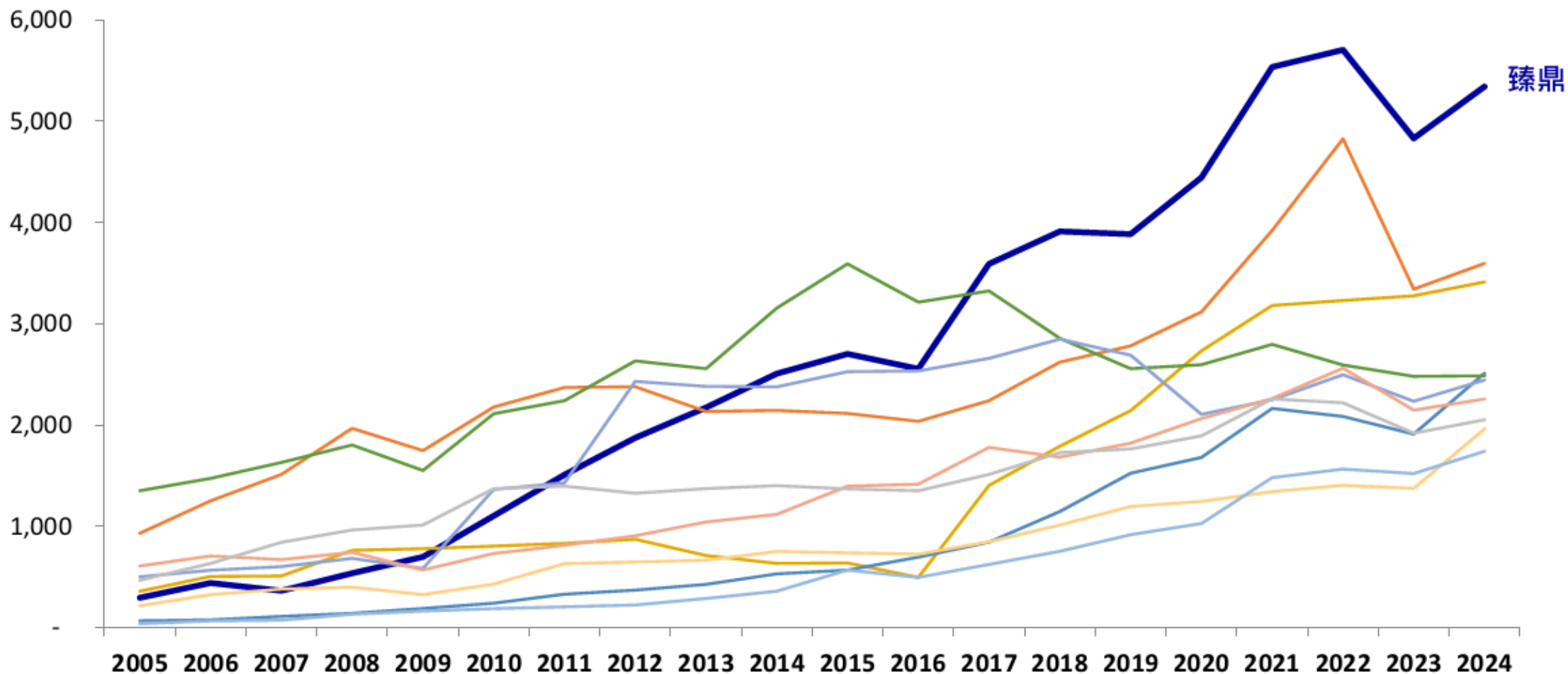


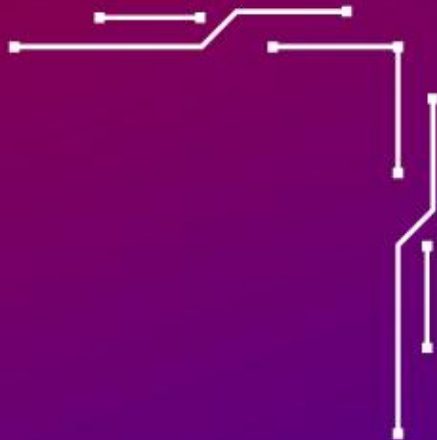
資料來源：Prismark

臻鼎保持與同業間的領先差距

2024年全球前十大PCB領導廠商營收趨勢

單位：百萬美元



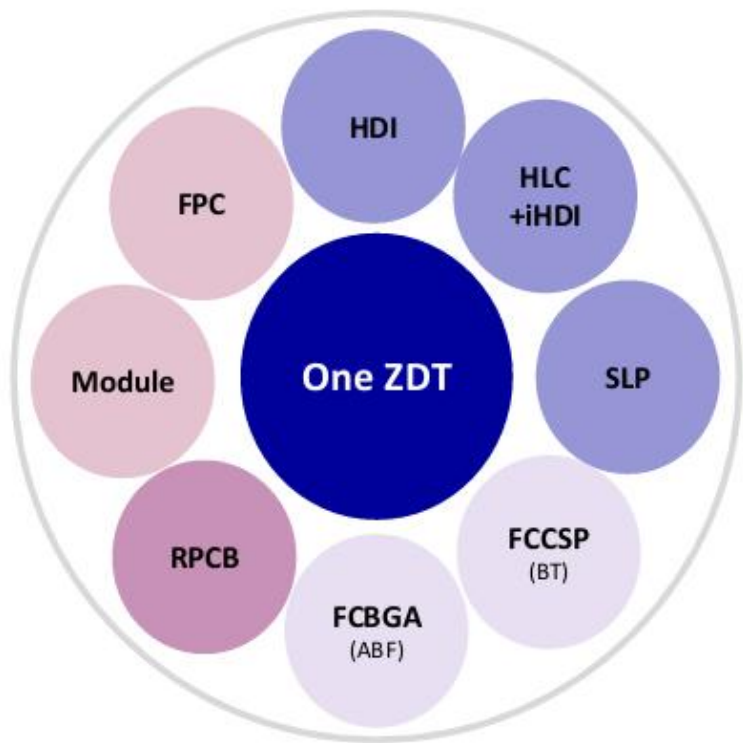


為何臻鼎能持續保持領先地位？



臻鼎：唯一橫跨全產品線的PCB領導者

憑藉One ZDT的全產品布局，臻鼎全面覆蓋AI時代的雲、管、端應用，提供最完整的解決方案，確保在PCB技術日益複雜的競爭中，穩居全球領導地位。



AI



AI 伺服器



邊緣運算
伺服器



高速運算
記憶體



光通訊



交換器



基地台



AI 手機/
晶片



AI PC/
平板



人形
機器人



智慧眼鏡/
AR/VR



智能穿戴



智能車用
智慧座艙
域控制器



自動駕駛
車用晶片
毫米波雷達



新能源車
電池板

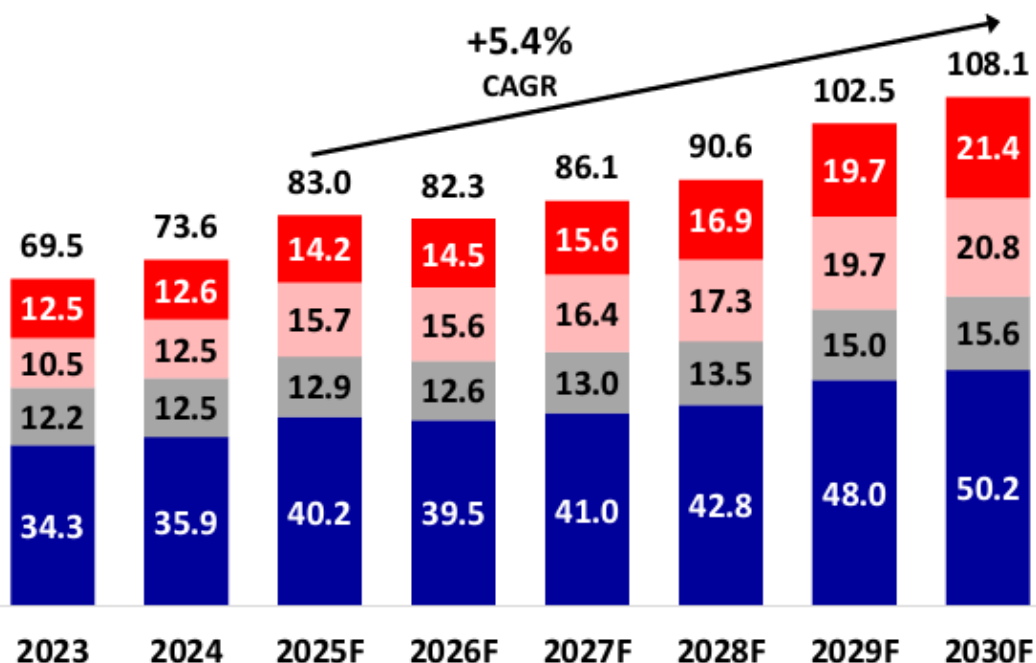
AI是推動PCB產業成長的重要動能， 臻鼎將以全產品優勢在AI時代拉開與同業的領先差距

各類 PCB皆受益於 AI 帶來的高階性能要求與產品創新浪潮，AI仍將是PCB產業未來數年的核心成長動能

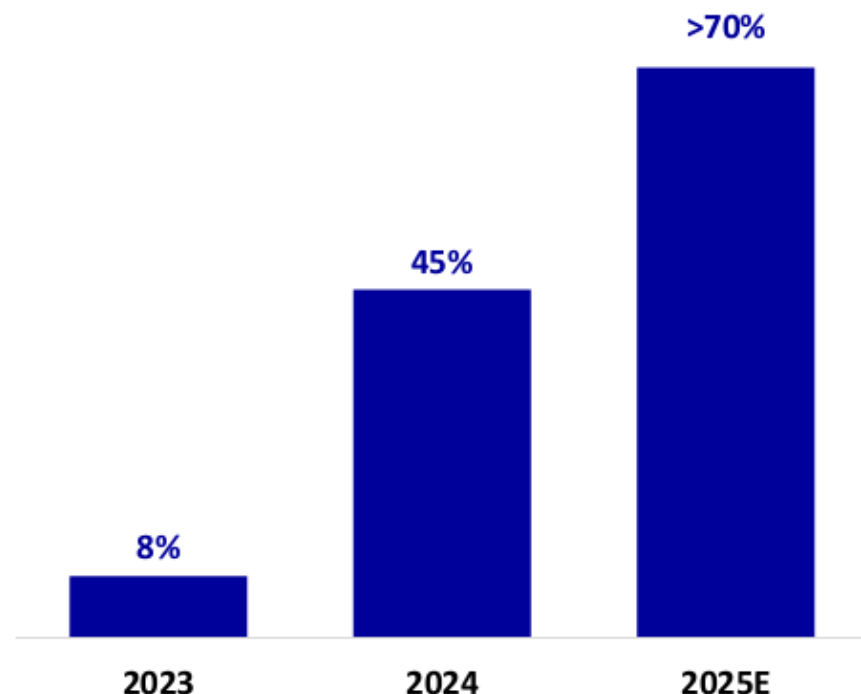
臻鼎全面覆蓋AI時代的雲、管、端應用，
AI營收佔比逐步提高

全球PCB各產品市場規模

■ RPCB ■ FPC ■ HDI ■ ICS Total (單位：US\$bn)



■ 臻鼎AI營收占比

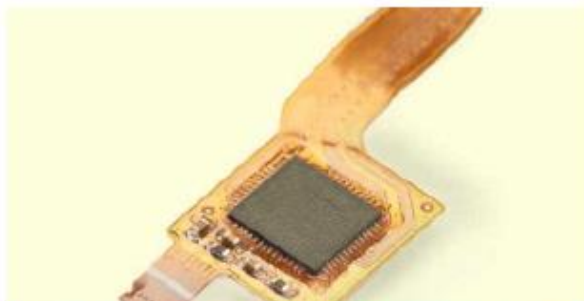


資料來源：Prismark (2025/9)；2026~30年係用Prismark數據推估。

過去幾年耕耘逐步發酵，臻鼎四大產品線將持續成長



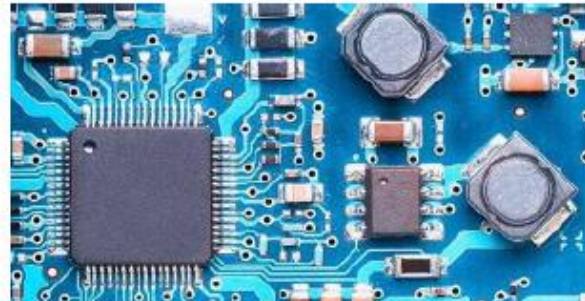
IC載板



軟性電路板



高密度連接板 (HDI)



硬質印刷電路板

2030目標

全球前5

2030目標

保持#1

2030目標

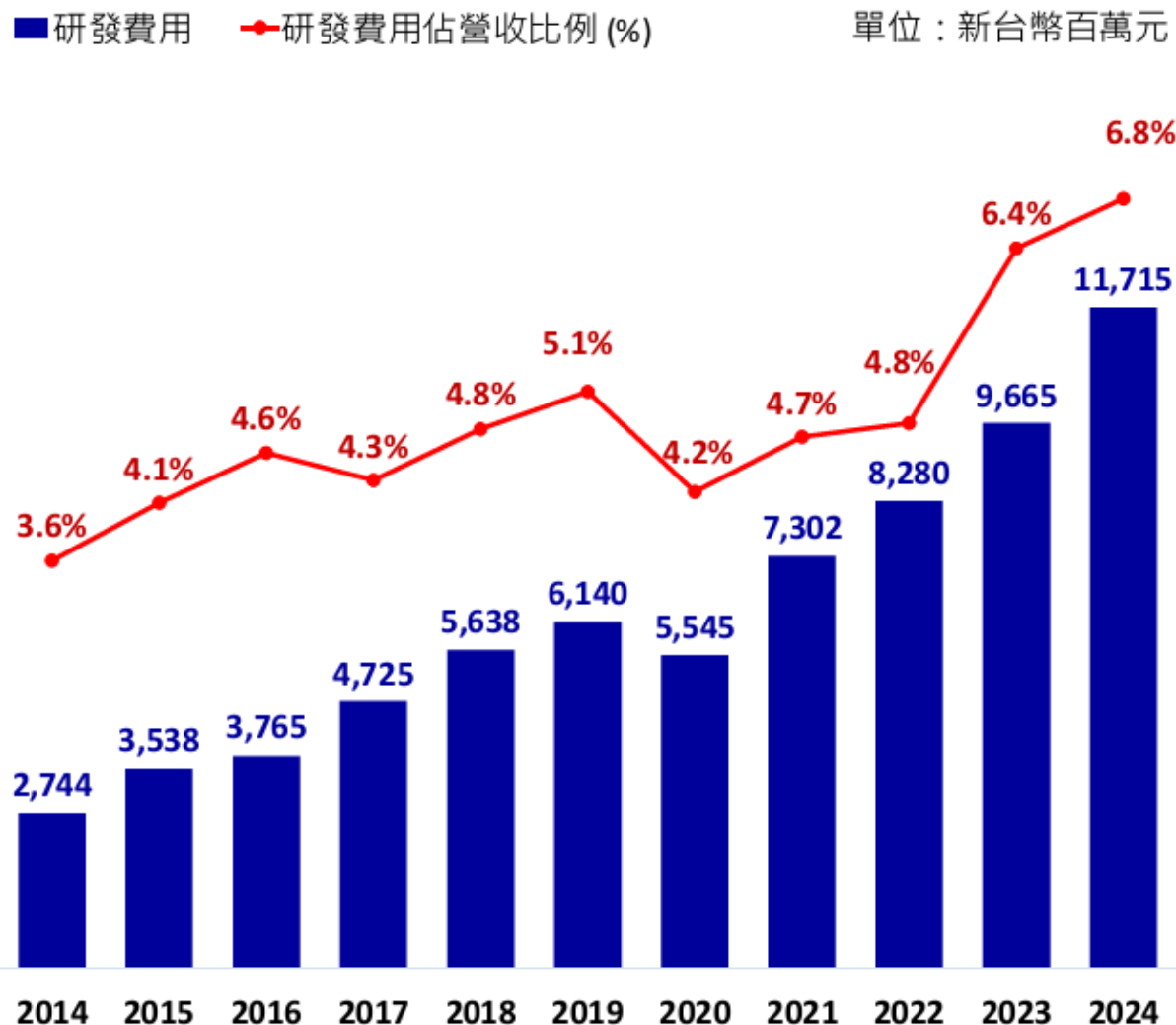
全球#1

2030目標

全球前10

深化與客戶及產業鏈夥伴合作，目標每年創造優於產業平均的營收與獲利成長

持續投入高階產品研發，鞏固產業領導地位



在印刷電路板和半導體相關開發計畫上，臻鼎遵循12字方針，研發高階技術並引入到各項具有前瞻性之領域應用中。

12字方針：

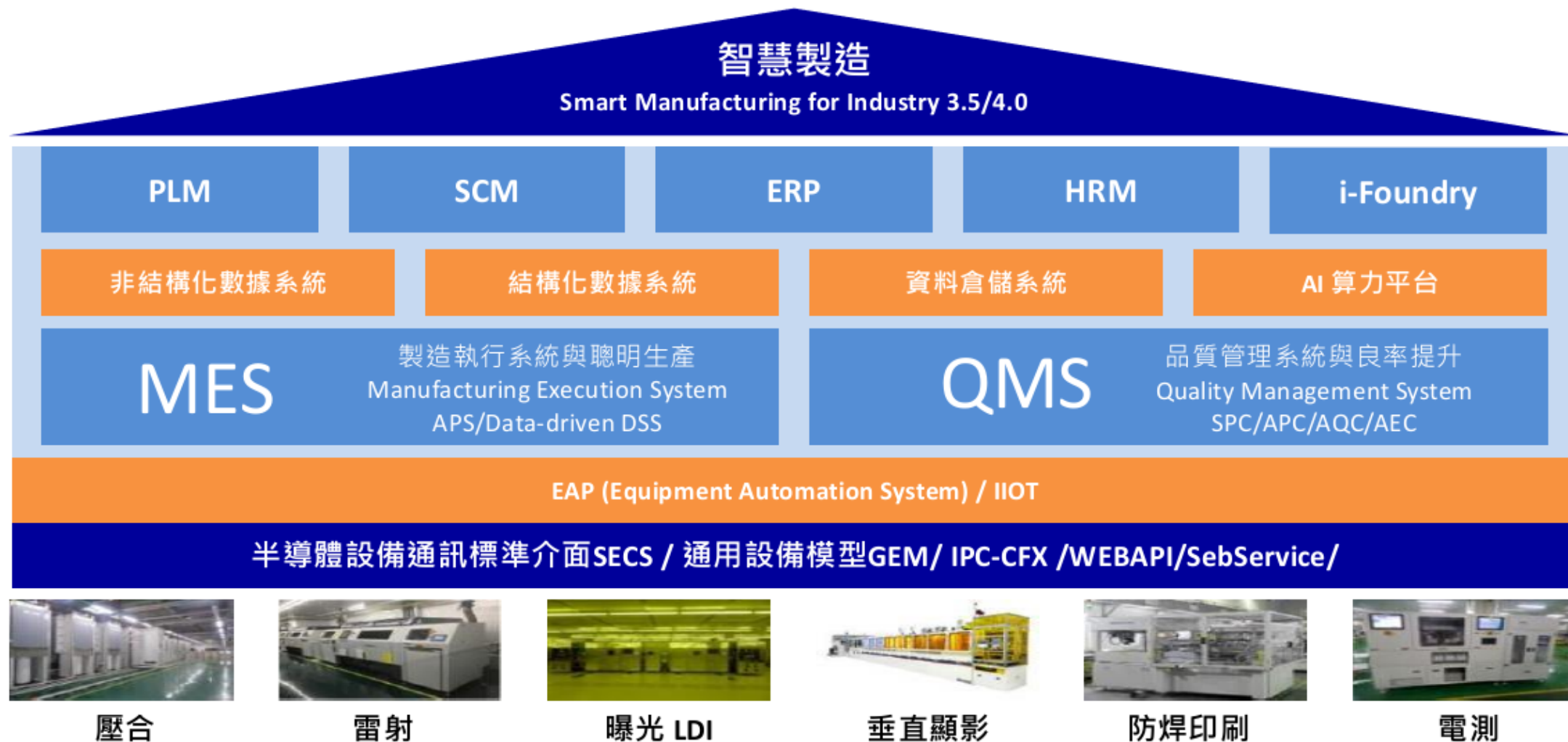
輕	輕型化	薄	薄型化	短	流程短	小	小型化
高	高頻、 高速、 高散熱	低	低污染、 低成本、 低功耗	多	多功能、 多層	快	快速研發、 快速製造
精	公差精進	美	美觀	細	細線路	智	智能化

實施台灣及大陸雙研發中心，持續提升新技術開發能力，以保持高端產品及技術之領先優勢。

多元生產基地建置高階產能，滿足全球客戶需求

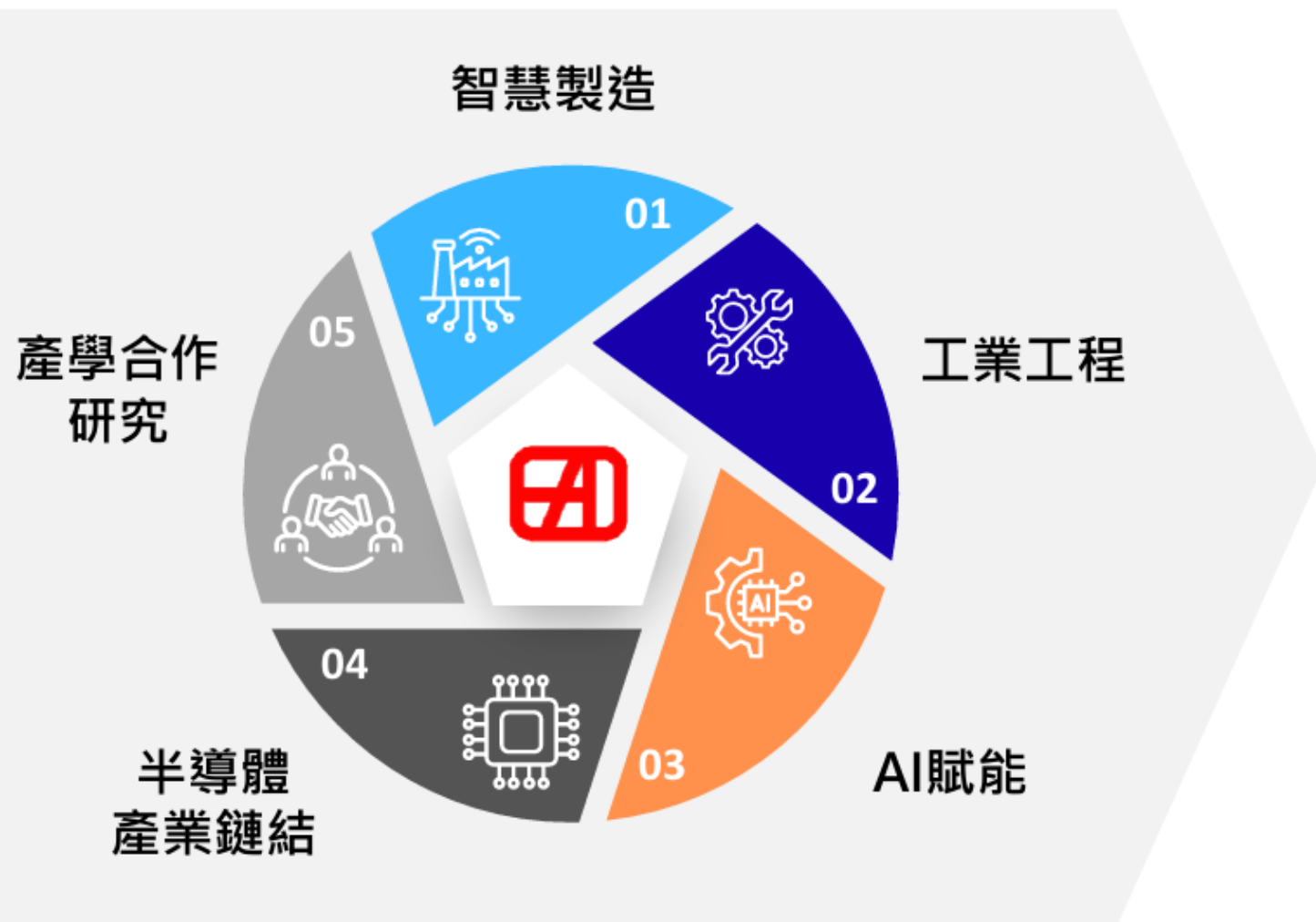


透過智慧製造，提高人均產值，創造更佳獲利



作業數位化、數位平台化、平台智能化、智能實戰化

團隊賦能，全面強化臻鼎營運韌性與永續競爭力



提高組織內外資源整合，
實現團隊賦能與結構性優化

AI智慧電路板學程

合作效益

1. 人才儲備與錄用：企業可直接參與學程規劃，學生依照產業需求受訓，畢業即能上手
2. 研發合作平台：結合學校實驗室資源，企業可藉由專題計畫，提前驗證新技術與新製程
3. 品牌形象與社會責任：共同推動學程，不僅能展現企業對教育與在地深耕的承諾，更能強化企業社會責任
4. 共享實習與獎學金制度：企業可提供暑期實習、學期實習與獎助學金，吸引優秀學生投入

合作方向

1. 共同定義人才應具備的專業知能與對應的課程藍圖，實踐學用合一
2. 學生修畢學程規定必修及選修門檻，企業授予學程修畢證書
3. 投遞履歷時主動檢附學程修畢證書者，將享有以下權益：
 - 保證面試
 - 經面試錄取，且學程科目表現優良平均達80分(含)以上者，**提供到任金18萬(服務需滿一年)**
4. 開設【**印刷電路板概論**】課程邀請業師授課，幫助學生進一步了解企業與產業知識

AI智慧電路板學程規劃



學程報名



了解更多

電路板基礎 (必修1+3)

印刷電路板概論

電子學一
電路學
半導體元件物理
半導體製程
材料分析與檢測
分析化學
流體力學
半導體製程設備
機器人自動化應用
實驗設計與統計
邏輯設計/數位邏輯

電路板核心 (必選4)

電磁學	機電整合與自動化應用
電漿工程與應用	感測技術基礎科學
材料科學	化學工程
熱力學	材料力學
儀器分析	程式語言/程式設計
表面物理/化學	數位訊號處理
材料表面工程	資料庫管理
物理化學	作業研究
有機化學	資料結構
材料化學	生產計劃
電機機械	

電路板專業 (選修3)

半導體元件設計與模擬	
材料機械性質	
熱傳學/輸送現象	材料物理性質
無機化學	智慧製造技術
電子材料	量測原理
高分子科學	機器學習/深度學習
化學/化工動力學	電子封裝技術
真空技術	人工智慧
電化學原理	積體電路封裝測試
可靠度工程分析	製造數據科學
應力分析	資料礦掘

臻鼎科技高雄AI園區

12.10(三) 14:00 邀請參訪



參訪報名



年輕人三對

選對產業 + 進對公司 + 跟對老闆 =

【臻鼎科技集團】



Thank You